



小米年内将交付10多万辆汽车 利好众多半导体企业

本报讯 记者张心怡报道：5月23日，小米集团在一季度财报中披露，小米智能电动汽车Xiaomi SU7系列累计锁单量达到88063辆，截至2024年5月15日累计交付新车已达到一万辆。在当晚的投资者电话会议上，小米集团合伙人兼总裁卢伟冰表示，小米的目标是确保今年交付10万辆车，并挑战交付12万辆车。

智能电动汽车涉及的半导体包括计算、控制、存储、信息安全、驱动、电源、通信、模拟、功率、传感器等10个品类，单车的半导体用量也从传统燃油车的600颗/辆至700颗/辆增长至智能汽车约2000颗/辆。

记者综合小米及供应商公开信息发现，小米SU7系列使用了传感器、计算芯片、功率模块等多种半导

体产品。小米汽车的年内交付目标将带动上述产品的供应需求。

在传感器方面，小米SU7 Pro及小米SU7 Max搭载禾赛超高清远距激光雷达AT128，分别于4月和5月开启交付。该款激光雷达以“瞭望塔式”布局于小米SU7的车顶，内部集成128个独立VCSEL激光器，远距探测能力达到200米，以每秒153万的超高频输出海量三维实时数据。

而计算芯片主要用于小米汽车的智能驾驶和智能座舱。智能驾驶主要采用了英伟达DRIVE Orin芯片平台，Pro版采用单颗Orin，算力达到84TOPS，Max版采用两颗Orin，算力达到508TOPS，智能座舱主要采用高通的骁龙8295座舱平台，AI算力达到30TOPS。

电机是电动汽车驱动系统的核心零部件。小米SU7系列搭载小米超级电机V6系列，包含V6、V6s以及V8s三款电机，配备自研SiC（碳化硅）电控。其中，V6和V6s电机是小米与联合汽车电子、汇川联合开发，V8s电机是小米自研。

据卢伟冰透露，在小米汽车的订单中，双电机版本的Max版占比最高，超过40%。这将进一步利好功率半导体尤其是碳化硅产品。

记者从企业的公开信息了解到，小米SU7单电机版400V电压平台搭载了联合汽车电子的电桥，应用了博世第二代750V、6.4毫欧的SiC芯片产品。小米SU7 Max前后电机均使用碳化硅模块，英飞凌为小米SU7 Max版供应两颗1200V HybridPACK Drive G2 CoolSiC模块。

除了半导体供应商，小米SU7系列的交付目标也将利好晶圆代工、封装测试等半导体产业链环节，包括算力芯片所需的逻辑代工，功率半导体所需的特色工艺，传感器相关的模组代工等。

在整合半导体产业链的同时，小米自身也在加码对半导体技术的研发。比如小米SU7系列的800V碳化硅高压平台为小米自研，有利于拉动碳化硅的上车量。此外，记者在国家知识产权局中国专利公布公告平台查询到，小米汽车科技有限公司于今年1月申请了“芯片封装方法及芯片封装结构”发明，该技术能够改善多芯片封装的均流性。据悉，小米内部将集团的“人车家全生态”战略拆解成了六大战略，芯片战略正是其中之一。

4月份日本对中国半导体制造设备出口额同比增长95.4%

本报讯 日本财务省最新发布的数据显示，受汽车、半导体设备出口增长拉动，日本当月出口额同比增长8.3%，达8.9807万亿日元，连续第五个月实现出口额增长，这也是1979年有可比数据以来4月份出口额的最高值。日本对中国的出口额增长9.6%，也是连续第五个月增长，其中半导体制造设备出口额同比大增95.4%，是当月出口增长的最大拉动因素。

记者了解到，自今年以来，中国市场对于日本半导体设备的营收起到了显著的带动作用。

近日，东京电子发布了2023财年（2022年4月1日—2023年3月31日）全年财务报告。在2023财年，东京电子实现净销售额达22090.25亿日元，较上一财年增长10.2%，其中，海外净销售额增长11.0%，至1969.08亿日元，出口中国的销售额占其中的44%以上。

东京电子在财报中指出，在2023财年，在逻辑芯片和晶圆代工稳健的投资意愿带动下，公司半导体制造设备业务部门销售额同比增长12.9%，至16927亿日元。预计在

新财年，公司营收将增长20%至2.2万亿日元，营业利润预计增长27.6%至5820亿日元。

Screen Holdings同样公布了2023财年财报，其营收年增长9.6%至5049亿日元，营收、营业利润、净利润皆创下历史新高。其半导体制造设备业务营收同比增长12.6%至4176亿日元，营业利润增长26.1%至970亿日元，营收、营业利润也皆创下历史新高。其中，中国市场营收暴涨111%至1987亿日元，营收占比自2022年度的21%大涨至39%，居所有市场之首。

Screen Holdings表示，来自PC、智能手机、服务器的需求预估将继续增长，特别是服务器需求预估将大增。在中国对成熟制程的投资、DRAM投资复苏等因素的带动下，预计2024年芯片前段制程制造设备（晶圆厂设备、WFE）市场将同比增长约5%。

SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙曾表示，全球半导体设备总销售额预计在2024年恢复增长，中国对半导体设备和材料的需求将持续保持强劲势头。

（许子皓）

2024年第一季度全球晶圆代工工业营收同比增长12%

本报讯 5月22日，研究机构Counterpoint发布的最新报告显示，2024年第一季度全球晶圆代工工业营收环比下滑5%，但同比增长12%，中芯国际以6%的份额首次升至第三名，华虹集团以2%的份额位居第六名。

Counterpoint表示，第一季度营收下滑不仅受季节性因素影响，也因为非人工智能半导体（如智能手机、消费电子、物联网、汽车和工业）需求放缓所致。这一趋势与台积电管理层的看法不谋而合，台积电此前将2024年逻辑半导体

行业的增长率预测从高于10%下调至约10%。

在全球前六大晶圆代工企业中，台积电第一季度业绩仍高居榜首，份额占比达62%，超出预期，台积电还将AI相关收入年复合增长率50%的持续时间延长至2028年。尽管预期CoWoS产能到2024年年底将同比增长一倍，但仍无法满足客户强劲的AI需求。值得注意的是，由于AI芯片的强劲需求，台积电5nm产能利用率一直保持强劲态势。三星为第二大代工厂，份额达

13%，三星Galaxy S24系列智能手机是一大亮点，但中低端手机需求相对疲软。三星预计，随着第二季度需求改善，晶圆代工收入预计出现两位数百分数反弹。

中芯国际在第一季度超越格芯、联电成为全球第三大晶圆代工企业，业绩超出市场预期，得益于CMOS图像传感器（CIS）、电源管理IC（PMIC）、物联网芯片和显示驱动IC（DDIC）等业务增长以及市场复苏。随着客户补充库存需求的扩大，中芯国际预计第二季度将继续保持增长。

联电、格芯分别位列第四名、第五名，二者均表示消费电子和智能手机需求已经触底，但汽车半导体需求喜忧参半。联电预计短期内汽车需求将放缓，格芯预计第二季度收入将呈上升趋势。

Counterpoint表示，2024年第一季度，已观察到半导体行业显露需求复苏迹象，尽管进展比较缓慢。经过连续几个季度去库存，渠道库存已经正常化。AI的强劲需求和终端产品需求复苏将成为2024年晶圆代工行业的主要增长动力。

（文编）

英特尔预计年内交付 超过4000万片AI PC处理器

本报讯 近日，英特尔官网发布消息称，将于2024年第三季度推出代号为Lunar Lake的客户端处理器，为来自20多家OEM的80多款新型笔记本电脑提供动力，为全球范围内的Windows11 AI PC带来AI性能。英特尔表示，凭借酷睿Ultra处理器的畅销以及Lunar Lake的加入，预计在今年内交付超过4000万片AI PC处理器。

AI PC集成了中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）和神经网络处理单元（NPU），每种处理器都具有特定的AI加速功能。其中，NPU是一种专用加速器，使得PC可以直接处理人工智能和机器学习（ML）任务，而不是将数据发送到云端进行处理。随着PC任务自动化、简单化和优化的需求日益增长，AI PC的出现变得越发

重要。

英特尔将Lunar Lake定义为突破性的AI PC移动处理器，AI性能比前一代产品高出3倍，其NPU的算力超过40TOPS，满足市场所需的Windows11 AI PC性能。除了性能更高的NPU之外，Lunar Lake的GPU具备超过60TOPS的算力，共计提供超过100TOPS的平台算力。英特尔方面表示，Lunar Lake也将为刚刚在微软Build开发者前瞻大会上发布的Copilot+PC提供人工智能性能。

此外，AI的全面发展需要强大的软件基础设施和硬件创新。作为AI PC加速计划的一部分，英特尔持续与超过100家ISV合作，以提升个人助理、音频效果、内容创作、游戏、安全、流媒体、视频协作等方面的AI PC体验。

（许子皓）

英伟达最新财季实现营收260亿美元 较去年同期增长262%

本报讯 近日，英伟达发布了截至今年4月28日的2025财年第一财季报告，各项数据全面超越预期。财报显示，英伟达在第一财季实现营收260亿美元，较去年同期增长262%，高于此前分析师预期的246.5亿美元；净利润达148.8亿美元，同比上升628%，高于预期的129亿美元。

分业务来看，英伟达最受关注的数据中心业务成绩又一次创下历史新高。英伟达第一财季数据中心业务营收为226亿美元，与上年同期相比增长427%，与上一财季相比增长34%。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯顿称，数据中心业务的增长源于Hopper架构GPU（例如H100）出货量的增加。这一季度的重要亮点之一是Meta宣布推出Llama 3开源大模型，他们使用了2.4万个H100 GPU。克雷斯顿介绍，大型云服务提供商大概

占据数据中心收入的45%左右。

同时，英伟达为第二财季营收给出了依然强劲的预期，预计为280亿美元，高于市场此前预期的268亿美元。此外，英伟达也宣布了拆股计划，预计1拆10股，在6月7日收盘后生效，高昂的股价下拆股无疑是对普通投资者的利好。另外，英伟达将季度现金股息从每股0.04美元提高150%至每股0.1美元。增加的股息相当于拆分后每股0.01美元，将于6月28日派发。

英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋表示，英伟达数据中心的增长得益于对Hopper芯片上生成式AI训练和强劲且不断增长的需求，公司已经为下一波增长做好了准备。Blackwell架构芯片已全面投入生产，为万亿参数规模的生成式人工智能奠定了基础。

（英言）

微软首批Copilot+PC 将搭载Arm架构的高通处理器

本报讯 记者张心怡报道：“Copilot+PC采用全新的系统架构，包括CPU、GPU和可实现每秒超过40万亿次运算（TOPS）的全新NPU（神经处理单元）。我们还在（支持Windows11运行环境的）最低硬件配置上对Windows11进行了重构，优化了性能和电池。因此，Copilot+PC是有史以来速度最快的Windows PC，比搭载M3处理器最先进的MacBook Air快58%。”微软公司副总裁兼消费品类首席营销官尤瑟夫·梅迪（Yusuf Mehdi）在日前举办的微软Build开发者前瞻大会上表示。

微软在本次活动上发布的Copilot+PC，被称为“有史以来速度最快、最智能的Windows PC”。在芯片层面，Copilot+PC整合了CPU、GPU以及高性能NPU的功能，并将芯片平台与运行在Azure云平台的大型语言模型（LLM）和小型语言模型（SLM）相连接，从而增强了整机的处理能力。在运行人工智能工作负载方面，Copilot+PC的性能提高了20倍，效率提高了100倍，并提供了业界领先的人工智能加速功能。其持续多线程性能比苹果15英寸MacBook Air高出58%，并提供全天候电池续航时间。

微软现场演示了一系列Copilot+PC的AI能力，包括与OpenAI最新技术GPT-4o的结合。在GPT-4o的支持下，Copilot根据用户实时的屏幕画面，以对话的方式引导用户在沙盒游戏《我的世界》中制造剑，包括根据用户的库存面板提醒他应该补充哪些材料，并在游戏中的“僵尸”袭

来时引导用户躲避等。同时，Copilot+PC推出了“回顾”（Recall）功能，帮助用户以更加符合人类记忆的方式，找到在电脑上看到或操作过的内容，比如根据用户的描述找到祖母在3周前浏览过的蓝色套装的图片并提供购买链接。微软Windows AI体验首席产品经理Carolina Hernandez表示，“回顾”功能的实现离不开NPU的支持。

现场披露的信息显示，微软首批推出的Copilot+PC将搭载高通骁龙X Elite和骁龙X Plus处理器，该系列处理器将提供算力达到45TOPS的NPU。高通表示，骁龙X Elite为笔记本电脑提供的每瓦NPU性能，与苹果M3相比最高可达2.6倍，与英特尔酷睿Ultra7相比最高可达5.4倍。

由于高通采用Arm架构而非英特尔、AMD主导的x86架构，微软也介绍了目前Windows操作系统与Arm适配的进展。据统计，在运行Windows10和Windows11的iGPU（集成GPU）笔记本电脑中，用户在87%的应用程序使用时间内，使用的是原生支持Arm的版本。目前Microsoft 365应用程序，以及国内的爱奇艺、哔哩哔哩、QQ音乐、有道翻译等也推出了Arm64原生版本。

虽然首批采用高通芯片，但微软也在与英特尔、AMD合作，预计后续将推出基于英特尔Lunar Lake和AMD Strix处理器的Copilot+PC，并将Copilot+PC推动与NVIDIA GeForce RTX和AMD Radeon等显卡的适配。